

Press Information

問合せ先: 下岡 耕平 (マキシム・ジャパン株式会社 広報)
03-3232-6141

米国マキシムが日本のエプソン社とのミックスドシグナル半導体製品の 製造および供給に関するパートナーシップ契約を発表

カリフォルニア州サニーベール — 2007年2月7日 — マキシム・インテグレートッド・プロダクツ (NASDAQ: MXIM; japan.maxim-ic.com、以下「マキシム」)は、セイコーエプソン株式会社(www.epson.jp、以下「エプソン社」)とパートナーシップ契約を結び、エプソン社がマキシムのパワーマネージメントおよびバッテリーマネージメントアプリケーションに向けた最先端のミックスドシグナル半導体製品を製造すると発表しました。これらの製品は山形県酒田市にあるエプソン社の最先端サブマイクロン 200mmファブ工場に製造され、主に日本とアジア太平洋地域の市場に向けて出荷されます。

今回の提携の一環として、マキシムとエプソン社は主要なミックスドシグナルプロセス技術を相互供与し、エプソン社の酒田工場に配備します。この技術移転はすでに始まっており、2007年中に量産へと本格稼働してまいります。

「この契約はマキシムとしても類がないもので、業界内でも初めてのケースとなるでしょう」とマキシムの Group President の Vijay Ullal。「マキシムの革新的なミックスドシグナル設計とプロセス技術の粋が、エプソン社のワールドクラスの半導体製造技術と結びつき、日本やアジア太平洋地域のお客様に新たなレベルの品質とサービスが確保されます。エプソン社の酒田工場はおそらく世界で最も自動化の進んだ200mmファブです。結果として、業界トップのミックスドシグナル製品品質とサイクルタイムを兼ね備え、同時に非常に競争力のあるコスト体系を実現するものと期待しています。」

マキシム社の President 兼 CEO の Tunc Doluca は以下のように述べています。「ゼロディフェクトの品質と納期短縮に対する期待に対して、業界はチャレンジに立ち向かい、お客様の最終市場の要求に応じていかなければなりません。マキシムでは今回のエプソン社との戦略的なパートナーシップの持つ可能性に大きく期待しており、新たな顧客満足のレベルに到達することができることを願っています。また、この提携は、現在設計中の民生用エレクトロニクス製品や車載用アプリケーションに向けたいくつかの重要な製品の将来的な生産能力拡大に貢献することになるでしょう。」

マキシム・インテグレートッド・プロダクツは、実信号処理を必要とするアプリケーションに向けた高品質のアナログおよびミックスドシグナル製品の主要な国際的サプライヤです。